

成功大學 鎔合團隊

鎔基漿料 高功率電子元件封裝技術

簡介

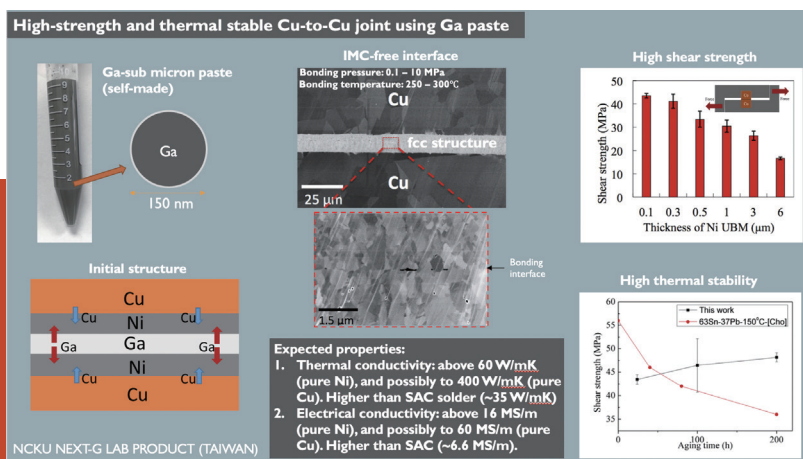
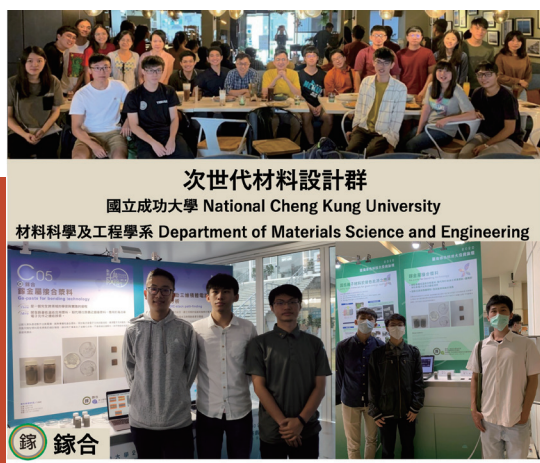
鎔合是國立成功大學材料系，次世代材料設計研究群衍生的團隊，結合新穎計算材料方法與關鍵實驗開發模式，旨在協助高功率封裝產業提供優質接合材料。

產品項目

鎔合漿料。

發展現況

臺灣雖盛產稻米，但因為飲食習慣的改變，稻米過剩狀鎔合團隊自製之鎔基漿料，以材料成本僅為銀1/4的鎔元素為原料，取代銀基漿料，實現以鎔基漿料接合高功率電子元件封裝技術。應用此鎔基漿料所製程之接合體可實現以下幾大接合優勢：低溫低壓接合製程、接合結構不含機械特性弱勢的介金屬化合物、優良的接合強度、接合強度不隨熱時效而衰退、優良的熱及電傳導特性等。



公司成立時間：N/A

實收資本額：N/A

專利保護狀況：已獲台灣、中國、日本及美國四國專利。

團隊人數：7

辦公室位置：臺南

公司網址：N/A

聯絡
窗口

李宗欣 (06)2757575或校內分機36000轉114
E-mail: leolee@mail.ncku.edu.tw

